



2026 年 10 月 13 日

各 位

会 社 名 ニデック株式会社
代表者名 代表取締役常務執行役員 南井 正之
取 引 所 東証プライム（6594）
所 在 地 京都市南区久世殿城町 338
問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 渡邊 啓太
電 話 （075） 935-6150

当社子会社の TPCA Show TAIPEI 2026 出展について

ニデック株式会社のグループ会社であるニデックアドバンステクノロジー株式会社は、2026 年 10 月 20 日（火）～10 月 22 日（木）に台北南港展示センターで開催される「TPCA Show TAIPEI 2026」に出展します。

2026 年 10 月 13 日

各 位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和
所 在 地 京都府向日市ニデックパーク 33 番地 C 棟

TPCA Show TAIPEI 2026 への出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2026 年 10 月 20 日(火)～10 月 22 日(木)に台北南港展示センターで開催される国際展示会「TPCA Show TAIPEI 2026」に出展します。



本展示会は、台湾プリント回路協会（TPCA）が主催し、エレクトロニクス、情報通信、制御機器などに使用される電子回路や実装技術、さらに電子基板の原材料や化学品など、PCB（プリント基板）業界に関連するあらゆる製品や技術が集結します。

当社は、「**AI 時代の品質を支える革新的な検査技術**」をテーマに、微細化と Heterogeneous Integration による大型化・高密度化が進むハイエンド回路基板の品質確保に向けて進化し続けるエレクトロニクス産業のニーズに応える最適化されたソリューションをご紹介します。

また、バックドリル向け X 線検査ソリューション、及びニデックグループのシナジーによって新たに誕生した自動搬送機「EFEM(Equipment Front End Module)」を実機展示いたします。既存の画像検査装置および電気検査装置もさらなる高精度化を遂げており、最先端製品の品質要求に応えるトータル検査ソリューションをご提案いたします。

〈出展概要〉

- ・会 期：2026 年 10 月 20 日(火)～10 月 22 日(木)
- ・会場：台湾台北南港展示センター（TaiNEX 1）
- ・ブース：K-725
- ・公式サイト：<https://www.tpcashow.com/en/>

〈主な展示内容〉

- ・FOPLP/RDL 向け導通/短絡検査装置「GATS[®]-7885」
- ・半導体パッケージ多面付けフルパネル基板検査装置「GATS[®]-8370」
- ・大型個片半導体パッケージ向け高精度検査装置「GATS[®]-7837」
- ・大型/多ピン基板向け導通絶縁検査装置「STAR REC[®]V6」
- ・CoWoP 対応 大型 HDI 向け導通/短絡検査装置「GATS[®]-8360」
- ・高密度基板対応 2D/3D 光学式検査装置「RSH Series」
- ・光モジュール・大型基板対応次世代 AI 外観検査装置「AURCA Series」
- ・TGV（Through Glass Via）向け高精度検査ソリューション
- ・狭ピッチ対応治具ソリューション「NS プローブ」

（実機展示）

- ・バックドリル向け高速 CT 型 X 線検査機
- ・Wafer 用自動搬送機 EFEM「AVR SMV 3000」※ニデックインスツルメンツとの共同開発